

HV93
Pad Function

1	HV _{OUT1}
2	HV _{OUT2}
3	HV _{OUT3}
4	HV _{OUT4}
5	HV _{OUT5}
6	HV _{OUT6}
7	HV _{OUT7}
8	HV _{OUT8}
9	HV _{OUT9}
10	HV _{OUT10}
11	HV _{OUT11}
12	HV _{OUT12}
13	HV _{OUT13}
14	HV _{OUT14}
15	HV _{OUT15}
16	HV _{OUT16}
17	HV _{OUT17}
18	HV _{OUT18}
19	HV _{OUT19}
20	HV _{OUT20}
21	HV _{OUT21}
22	HV _{OUT22}
23	HV _{OUT23}
24	HV _{OUT24}
25	HV _{OUT25}
26	HV _{OUT26}
27	HV _{OUT27}
28	HV _{OUT28}
29	HV _{OUT29}
30	HV _{OUT30}
31	HV _{OUT31}
32	HV _{OUT32}
33	OE
34	Data In
35	LE
36	V _{DD}
37	V _{PP}
38	GND
39	CLK
40	NC
41	Data Out

HV94
Pad Function

1	HV _{OUT32}
2	HV _{OUT31}
3	HV _{OUT30}
4	HV _{OUT29}
5	HV _{OUT28}
6	HV _{OUT27}
7	HV _{OUT26}
8	HV _{OUT25}
9	HV _{OUT24}
10	HV _{OUT23}
11	HV _{OUT22}
12	HV _{OUT21}
13	HV _{OUT20}
14	HV _{OUT19}
15	HV _{OUT18}
16	HV _{OUT17}
17	HV _{OUT16}
18	HV _{OUT15}
19	HV _{OUT14}
20	HV _{OUT13}
21	HV _{OUT12}
22	HV _{OUT11}
23	HV _{OUT10}
24	HV _{OUT9}
25	HV _{OUT8}
26	HV _{OUT7}
27	HV _{OUT6}
28	HV _{OUT5}
29	HV _{OUT4}
30	HV _{OUT3}
31	HV _{OUT2}
32	HV _{OUT1}
33	OE
34	Data In
35	LE
36	V _{DD}
37	V _{PP}
38	GND
39	CLK
40	NC
41	Data Out

HV97
Pad Function

1	HV _{OUT1}
2	HV _{OUT2}
3	HV _{OUT3}
4	HV _{OUT4}
5	HV _{OUT5}
6	HV _{OUT6}
7	HV _{OUT7}
8	HV _{OUT8}
9	HV _{OUT9}
10	HV _{OUT10}
11	HV _{OUT11}
12	HV _{OUT12}
13	HV _{OUT13}
14	HV _{OUT14}
15	HV _{OUT15}
16	HV _{OUT16}
17	HV _{OUT17}
18	HV _{OUT18}
19	HV _{OUT19}
20	HV _{OUT20}
21	HV _{OUT21}
22	HV _{OUT22}
23	HV _{OUT23}
24	HV _{OUT24}
25	HV _{OUT25}
26	HV _{OUT26}
27	HV _{OUT27}
28	HV _{OUT28}
29	HV _{OUT29}
30	HV _{OUT30}
31	HV _{OUT31}
32	HV _{OUT32}
33	Blanking
34	Data In
35	LE
36	V _{DD}
37	V _{PP}
38	GND
39	CLK
40	POL
41	Data Out

HV98
Pad Function

1	HV _{OUT32}
2	HV _{OUT31}
3	HV _{OUT30}
4	HV _{OUT29}
5	HV _{OUT28}
6	HV _{OUT27}
7	HV _{OUT26}
8	HV _{OUT25}
9	HV _{OUT24}
10	HV _{OUT23}
11	HV _{OUT22}
12	HV _{OUT21}
13	HV _{OUT20}
14	HV _{OUT19}
15	HV _{OUT18}
16	HV _{OUT17}
17	HV _{OUT16}
18	HV _{OUT15}
19	HV _{OUT14}
20	HV _{OUT13}
21	HV _{OUT12}
22	HV _{OUT11}
23	HV _{OUT10}
24	HV _{OUT9}
25	HV _{OUT8}
26	HV _{OUT7}
27	HV _{OUT6}
28	HV _{OUT5}
29	HV _{OUT4}
30	HV _{OUT3}
31	HV _{OUT2}
32	HV _{OUT1}
33	Blanking
34	Data In
35	LE
36	V _{DD}
37	V _{PP}
38	GND
39	CLK
40	POL
41	Data Out



Pad Coordinates in Microns

1	0; 0
2	10; 168
3	10; 328
4	10; 1600.5
5	10; 1793.5
6	330; 2288
7	490; 2288
8	1300.5; 2341
9	1261; 2181
10	1261; 2021
11	1261; 1861
12	1261; 1665
13	1193; 83.5
14	814; -14
15	394; -14

HV91

Pad	Function	Pad	Function
1	COMP	9	-V _{IN}
2	Reset	10	NC
3	Shutdown	11	Output
4	V _{REF}	12	Sense
5	Discharge	13	+V _{IN}
6	OSC IN	14	BIAS
7	OSC OUT	15	FB
8	V _{DD}		

Die Specifications

	mils	mm	
Die Size:	65 x 105	1.650 x 2.670	Back Side Metal: None
Die Thickness:	20 ±1	0.50 ±0.02	Back Side Potential: -V _{IN}
Bond Pad Size:	3.3 x 3.3	0.084 x 0.084	Die Attach Material: Epoxy Ablestick 84-1 LMIS
Bond Wire Size:	1.25	0.032	Bond Pad Metal: Al/Si

■ 8773295 0004897 840 ■